

**第2次 「tok チャレンジ 2 1」  
2004年度の課題と方針**

2004年5月20日

# 初年度（2003年度）の総括

微細加工技術の「横」への展開が国内外で進行

## 海外展開の強化

CFPR（LCD材料）

ArFレジスト  
KrFレジスト

フレキシソ印刷材料(エラスロン)

TPAR（LCD材料）

販売拠点・SEの拡充  
TTW能力増強決定

中国製造合弁会社設立決定

## 微細加工技術の多角的展開

CFPR（LCD材料）  
リブ形成用ドライフィルムレジスト  
誘電体シート

ArFレジスト  
ArF液漫カバーコート材  
KrFレジスト

TPAR（LCD材料）  
SOG  
MEMS分野M&E

## コスト競争力の強化

TFTレジスト

フレキシソ印刷材料(エラスロン)  
回路基板材料

装置

# 収益目標に対する進捗状況

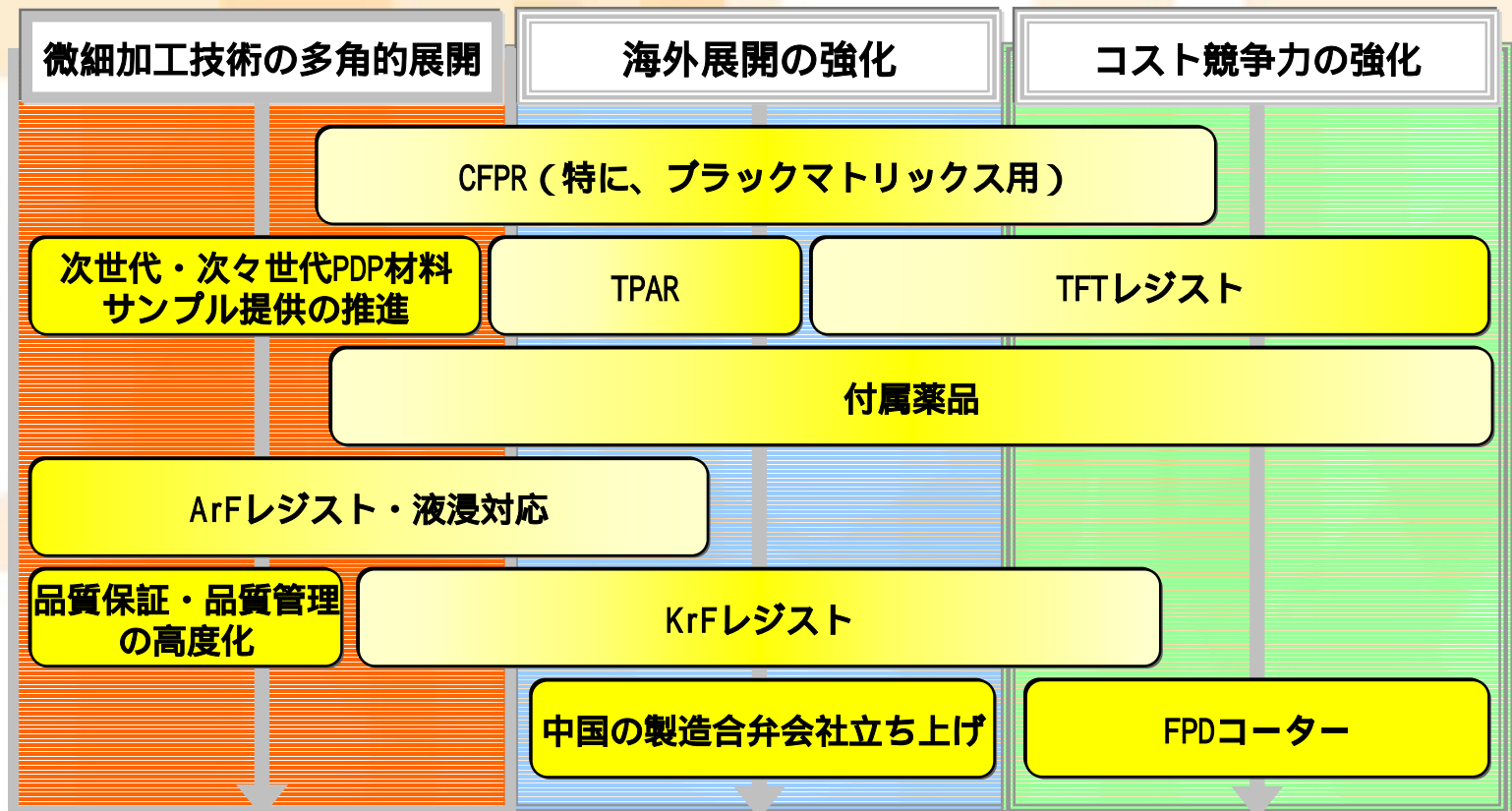
(百万円)

	2006/3 目標
売上高	93,800
電子材料	46,300
液晶材料	14,300
PDPパッケージング材料	10,200
印刷化材	8,200
装置	14,800
営業利益	9,100
経常利益 (経常利益率)	9,200 (9.8%)
当期純利益	5,000
海外売上比率	58%

	2003/3 実績	2004/3 実績	2005/3 予想
	72,286	83,121	91,900
	38,435	40,053	42,100
	11,554	13,083	17,000
	6,548	7,670	9,000
	6,185	6,162	6,600
	9,561	16,165	17,200
	4,563	5,703	8,200
	4,838 (6.7%)	6,036 (7.2%)	8,300 (9.0%)
	1,924	4,751	4,600
	49%	53%	53%

# 2004年度の重点課題と方針

評価実績の積上げは勿論、海外売上の伸長を図る



# 課題：CFPRの拡販強化

## ■ 2003年度の成果

### ■ 輸出货量・金額ともにBMを牽引役に大幅増を実現

✓ クロムBM法から樹脂BM法への動き

（従来品に比べると、環境に優しい製品。欧州の環境規制強化の動き）

### ■ サンプル提供・評価開始のユーザー拡大

### ■ BM増強設備を新設、稼動開始（宇都宮）



## ■ 2004年度の課題と方針

### ■ 採用実績の積み上げ

✓ 国内・・・携帯電話用TFT

✓ 海外・・・モニター・テレビ用TFT

### ■ 新設ライン需要の獲得推進

✓ 新規感光システムによる高感度化

✓ カーボン分散性の改良による高OD値化（遮光性アップ）

# 課題：中国製造合弁会社の立ち上げ

## 成長市場へのコミット強化

### ■ ねらい：

- 高成長が期待できる中国市場での需要獲得
- 価格競争に対する抵抗力アップ
- 日・台・中の3拠点による柔軟なアジア戦略の推進

### ■ 社名：

- 長春応化（常熟）有限公司

### ■ 製造・販売品目：

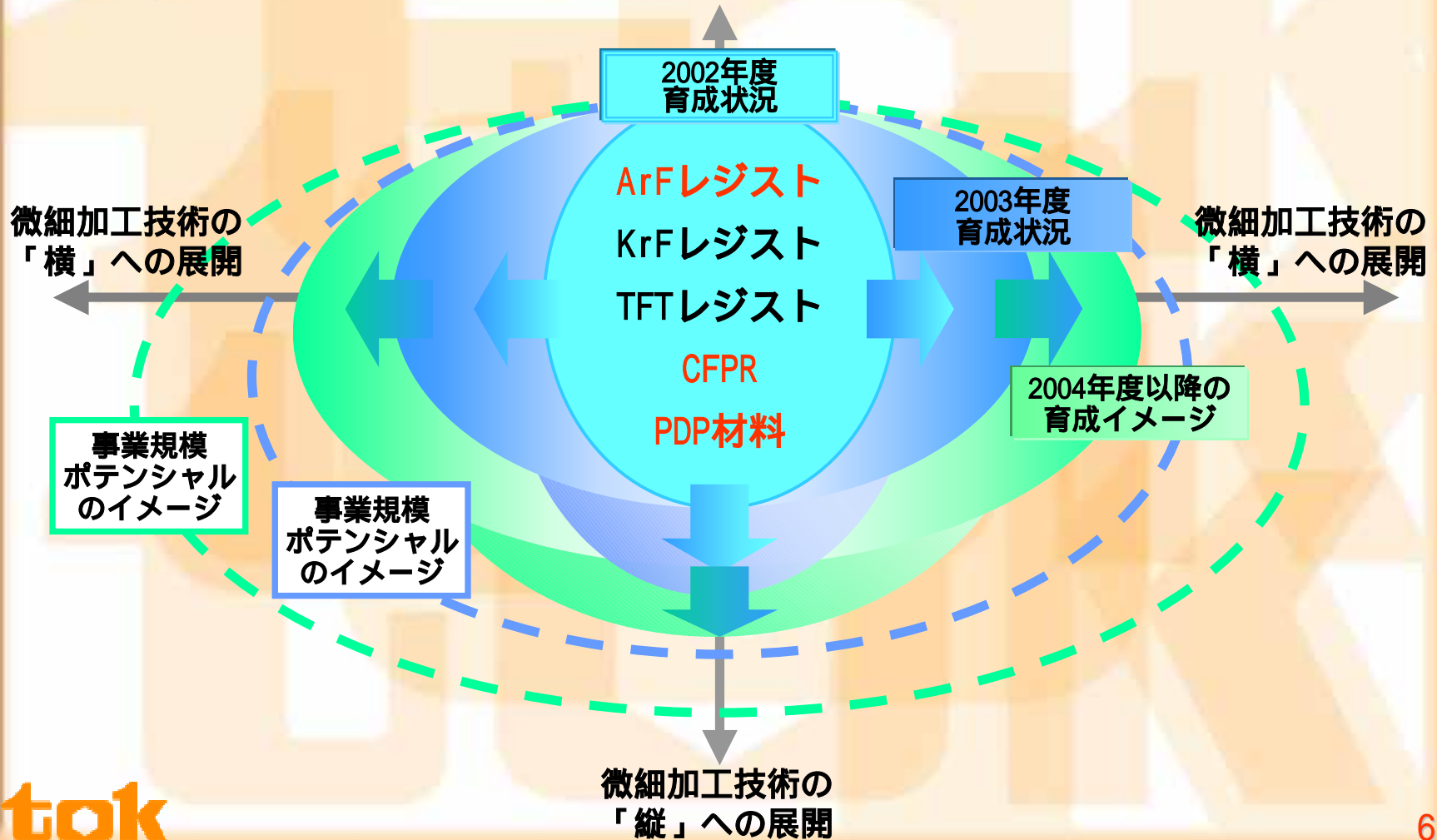
- 半導体・LCD製造用シンナー & 現像液

### ■ 建設着工・生産開始：

- 建設着工：2004年8月（設備投資額：約10億円）
- 生産開始：2005年4月予定（初年度売上計画：約5億円）

# 2004年度以降の売上拡大策

## 売上拡大とポテンシャルを高める製品群の育成強化



<http://www.tok.co.jp/>

**（ご注意）**

本資料の業績予想は、現時点において見積もられた見通しであり、これまでに入手可能な情報から得られた判断に基づいております。したがって、実際の業績は、様々な要因やリスクによりこの業績予想とは大きく異なる結果となる可能性があり、いかなる確約や保証を行うものではありません。